

产品特点:

K-5204K 有机硅导热胶既有粘接作用，又有优异的导热（散热）性。是一种经过补强的中性有机硅弹性胶，胶固化后有好的耐高低变化性能，长期使用不会脱落，不会产生接触缝隙降低散热效果；因为有了补强，该胶有较高的粘接强度，剪切强度≥15 公斤/平方厘米。具有优异的耐高低温性能。它的使用温度范围为-60~200℃；该胶是一种单组分室温固化胶，用 50 毫升金属软管包装使用非常方便。

用途:

最主要的应用是代替导热硅脂（膏）作 CPU 与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。用此胶后可以除掉传统的用卡片和螺钉的连接方式，带来的结果是更可靠的填充散热、更简单的工艺、更经济的成本。

技术性能:

		性能名称	K-5204K(快干型)	备注
固 化 前		外观	白色膏状	目测
		密度 (g/cm ³)	2.5±0.2	GB/T13354-92
		表干时间 (25℃, min)	≤10	
	固 化 后	机 械 性 能	抗拉强度(MPa)	≥2.0
扯断伸长率 (%)			≥65	GB/T528-2009
剪切强度 (MPa)			≥1.5	GB/T7124-2008
硬 度(shore A)			50~65	GB/T531.1-2008
电 性 能		介电强度 (kV/mm)	≥15	GB1695-81
		介电常数 (@100Hz)	≤3.0	GB/T1693-2003
		体积电阻 (Ω.cm)	≥1×10 ¹⁴	GB/T1692-92
	导热系数 (w/m.k)	1.6±0.32	ASTM D5470	

使用方法:

- 1、将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀将被粘面合拢固定即可。
- 3、将被粘好或密封好的部件置于空气中,让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在 24 小时以内(室温及 55%相对湿度)胶将固化 2-4mm 的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。

注意事项: 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

包装规格: 80g/支、300ml/支、2.6L/桶，也可根据用户需要商定。

贮 存: 密封贮存于 30℃以下阴凉干燥处，80g/支贮存期为 12 个月，300ml/支贮存期为 9 个月，2.6L/桶贮存期为 6 个月。

说明: 以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不承担特定条件下使用我公司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和我公司技术服务部联系，我们将竭力为您提供尽可能的帮助。